

平成18年度事業計画書

自：平成18年4月 至：平成19年3月

1. 全般

- (1) 学会の理念・ビジョン及びコアコンピタンスを制定し宣言するとともに、JIEP 発展構想委員会による施策を展開することにより、本学会が実装技術の柱であることを内外に示す。
- (2) Webを活用した情報発信・情報交換の更なる強化によって会員サービスの充実を図り、ユビキタス社会にふさわしい学会づくりを推進する。
- (3) 国際交流活動の推進を通して、技術ならびに情報の交流の活性化を目指す。
- (4) 関西、九州地区での地域独自の事業の活発化によって、地域における情報発信・情報交流を活性化し、中小企業の活動支援と共に、会員の拡大を図る。
- (5) 各種事業の運営費用削減努力、および事務局費の節減で財務の健全化を図る。

2. 国際会議・学術講演大会・展示会等の開催 (定款第4条第1号関係)

- (1) IEEE CPMT Japan Chapter と共催で、第10回目の国際会議「ICEP 2006」(2006.4.19～21, 於：品川プリンスホテル) 開催
- (2) 2006 マイクロエレクトロニクスショー(「最先端実装技術・パッケージング展」)は、JPCA Show 2006 と同時開催(2006.5.31～6.2, 於：東京ビッグサイト)。また、「最先端実装技術シンポジウム」を併催。
- (3) 「第21回エレクトロニクス実装学会講演大会」(2007.3, 於：東京大学等関東圏) 開催
- (4) 先端技術セミナーの開催
・定例セミナー開催3回を予定
- (5) 「第16回マイクロエレクトロニクスシンポジウム」(2006.10.26～27, 於：大阪大学) 開催

3. 調査・研究活動 (定款第4条第2号関係)

- (1) ワークショップの開催
・2006 ワークショップ(修善寺)(2006.9.7～8)
・関西ワークショップ 2006(2007.2)
- (2) 技術運営委員会とその傘下にある技術委員会の再編と見直しを行ない、活動の活性化を図る。そして、技術委員会において実装技術に関する技術的な諸課題と今後の動向を調査研究し、公開研究会、セミナー、シンポジウム等を開催。

4. 普及・啓発活動 (定款第4条第3号関係)

学会賞の授与、技術講習会・入門講座・技能検定試験講習会等の教育事業活動の充実。

- (1) 「エレクトロニクス実装学会賞」等の授与
- (2) 「実装技術入門講座」
- (3) 「PWB 製造技術講座(入門コース & 中級コース)」
- (4) 「実装技術総合講座」
- (5) 「光実装技術実践教育講座(入門編)」

5. 情報収集及び提供活動 (定款第4条第4号関係)

- (1) 「エレクトロニクス実装学会誌」の発行
会員の技術・研究活動の成果として発表される研究論文、総合論文、速報論文、技術論文、解説等を学会誌に掲載し、エレクトロニクス実装の技術と研究に関する最新の情報を収集・提供する。

- (2) 各種技術委員会・研究会の成果報告テキストの発行
- (3) Web 利用による会員サービス, 情報発信のさらなる強化
- (4) 海外の技術情報を提供

6. 内外機関等との交流・協力活動 (定款第 4 条第 5 号関係)

- (1) IMAPS との連携強化
- (2) 海外の国際会議の開催に協力・会員の参加への支援
- (3) アジア連絡委員会との連携
- (4) 電子 SI 連絡協議会との連携

7. 地域交流活動の促進 (定款第 4 条第 6 号関係)

- (1) 関西支部における各種事業の開催
- (2) 九州支部の拡充

8. その他

- ・ 広報活動の積極化, および会員増強運動の強化